

Compression Molding System

LCM1010-A



**Automatic compression molding system
for mass production of LED packages**

LEDパッケージの量産に適した 全自動コンプレッションモールド装置

製品情報



日本語

- 液状ディスペンス対応によるシリコン樹脂の自動供給
- コンプレッションモールド成形で材料の使用効率向上
- 均一で安定したレンズ形状、及び高精度な成形品を実現
- プレスモジュールの増減による生産数量の変化への対応



SPECIFICATION

Items		Unit	Description			
モデル		—	LCM1010-A			
ワークタイプ		—	基板・リードフレーム			
ワークサイズ		mm	1 strip: 70—150(W)×70—150(L) 2 strip: 45—70(W)×50—150(L)			
樹脂		—	液状			
マシンタイム		sec	37			
外形寸法	プレス数	module	1	2	3	4
	幅	mm	2,550	3,190	3,830	4,470
	奥行き	mm	1,400	1,400	1,400	1,400
	高さ	mm	1,700	1,700	1,700	1,700
重量		ton	3.6	5.4	7.2	9.0
成形取り数		workpiece	2	4	6	8
マガジンスペース		mm	300			
クランプ出力		kN/(tf)	29.4—98.0/3.0—10.0			
クランプ速度		mm/sec	52 (Max.)			
品種切替え方式		—	キット交換式			
リリースフィルム幅		mm	1 strip: 210 (Max.) 2 strip: 110 (Max.)			
ディスペンサタイプ	プリミックスタイプ	—	○			
	2液タイプ	—	○			

- ・上記数値は当社標準機の場合です。
- ・改良のため仕様を変更する事があります。
- ・特殊システム仕様についてはご相談ください。
- ・外形寸法はプリミックスタイプディスペンサを採用時のものを記載しています。



本社

〒601-8105
京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地

お問い合わせ先



TOWA (当社のハウスマーク)、 はTOWA株式会社の商標または登録商標です。

海外販売拠点

中国
TOWA (Shanghai) Co., Ltd.
台湾
TOWA Taiwan Co., Ltd.
韓国
TOWA Korea Co., Ltd.
シンガポール
TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.
マレーシア
TOWA Malaysia Sales & Services Sdn. Bhd.
タイ
TOWA THAI COMPANY LIMITED

フィリピン
TOWA Semiconductor Equipment Philippines Corp.
インド
TOWA SEMICONDUCTOR INDIA PRIVATE LIMITED
ドイツ
TOWA Europe GmbH
オランダ
TOWA Europe B.V.
アメリカ
TOWA USA Corporation

20250401-004-HQ